

部品内蔵基板：パワーエレクトロニクス

様々なタイプの能動部品／受動部品をPCB内に直接内蔵

Thank you for visiting the AT&S booth. Visit ats.net for more information.

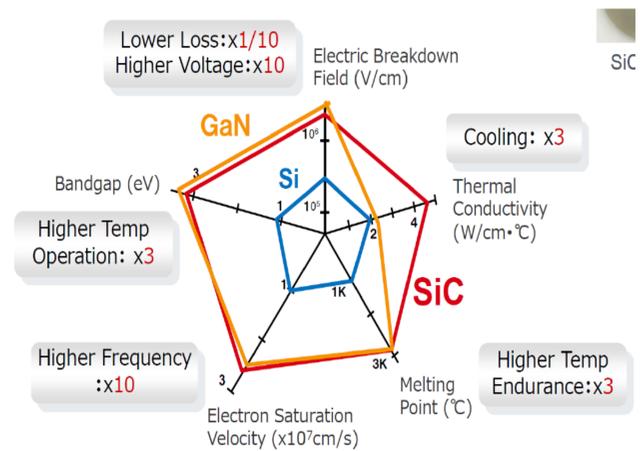


次世代半導体材料が要求する新たなパッケージング技術

- 高電圧: > 800V (1200V peak)
- 高温: > 200°C
- ワイドギャップ半導体の高速スイッチングに対応した低ループインダクタンス

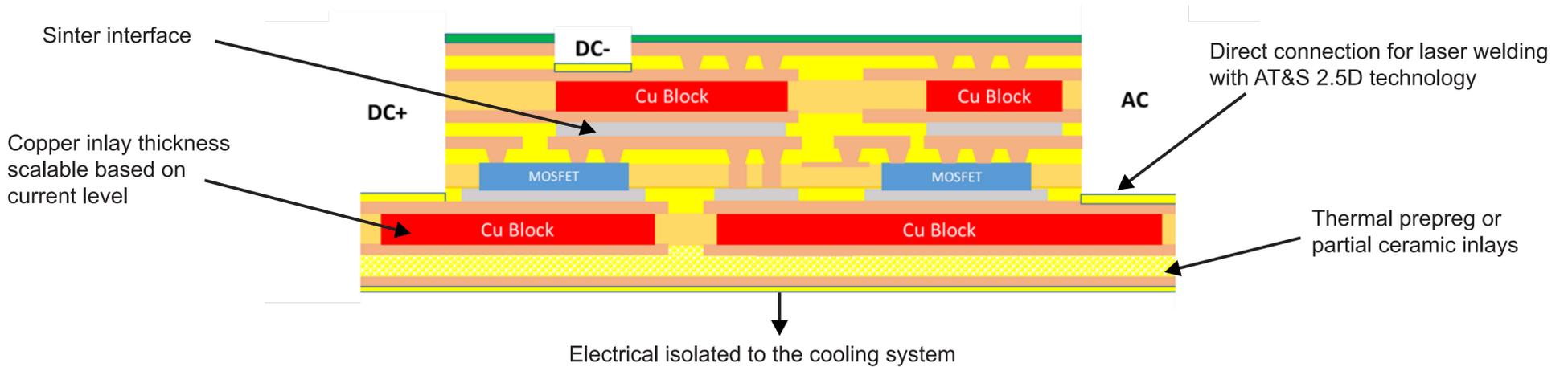
(車載向け需要事例)

- インバーター、コンバーターの効率向上は、走行距離を伸ばすだけでなく、バッテリーシステムトータルのコストを抑えることができる。
- 車メーカー毎にインバーター、コンバーターはカスタマイズされる。



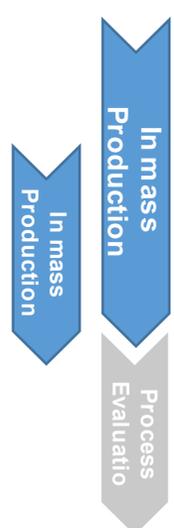
車載向け800Vインバーター

- 部品内蔵技術はレーザービア接続による低ループインダクタンスを実現する。
- 電圧のオーバーシュートを低減し、デバイス内の駆動スペースを拡張する。
- 新規基材は200°Cを超える動作温度にも対応し、4kV以上の絶縁耐圧にも対応する。



AT&S部品内蔵技術

SHA AUT



ECP®
The first choice for cost-efficient packaging of passive and small-size active components. Suitable for low voltage applications (<50V).

CENTER CORE EMBEDDING
The preferred packaging technology for power applications with double-sided component connection.

PARSEC²
The thinnest possible embedded package for active components with a wide range of metallization types.

